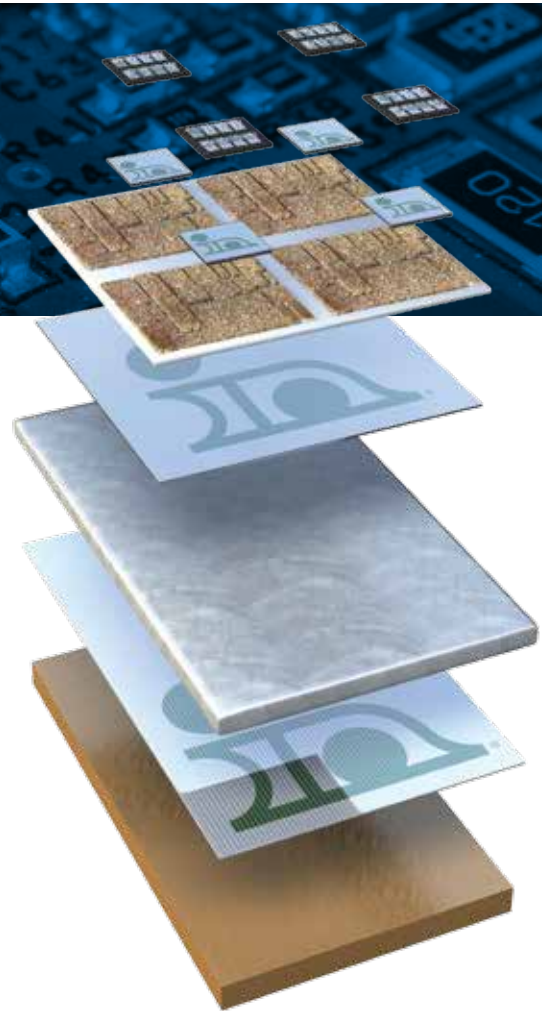


SOLDER REDEFINED

Products for IGBT Assembly

- Die-Attach
 - InFORMS®
 - BiAgX®
 - Ultra-pure solder ribbon
- Substrate-Attach
 - InFORMS®
 - Ultra-pure solder ribbon
 - LV1000 flux coating
- Heat-Sink-Attach with Heat-Spring® Technology
 - Indium-contained Heat-Spring®: up to 86W/mK
 - HSMF Heat-Spring®: silicon-free polymer TIMs
 - Sn+ Heat-Spring® for high-demand applications



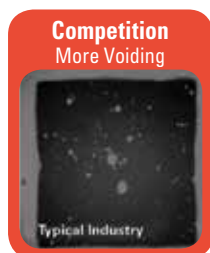
DIE-ATTACH SOLDERS

InFORMS®:

- Low-voiding
- Minimizes substrate and die tilt
- High-reliability

Indium8.9LDA:

- Developed for IGBTs and vacuum soldering
- Very low-voiding
- Excellent wetting



Common Name	Composition	Solidus (°C)	Liquidus (°C)
Sn63	63.0Sn/37.0Pb	183 (eutectic)	
SAC105	98.5Sn/1.0Ag/0.5Cu	217	225
SACm®	98.5Sn/0.5Ag/1.0Cu+Mn	217	225
Indalloy®241	95.5Sn/3.8Ag/0.7Cu	220	217
Indalloy®256	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu	220	217
Indalloy®121	96.5Sn/3.5Ag	221 (eutectic)	
"J" alloy	65.0Sn/25.0Ag/10.0Sb	223 (eutectic)	
SnCu	99.3Sn/0.7Cu	227 (eutectic)	
Sn992	99.2Sn/0.5Cu+Bi+Co	227 (eutectic)	
Indalloy®133	95.0Sn/5.0Sb	240	235
Indalloy®259	90.0Sn/10.0Sb	250	272
Indalloy®182	80.0Au/20.0Sn	280 (eutectic)	
Indalloy®228	88.0Pb/10.0Sn/2.0Ag	290	267
Indalloy®151	92.5Pb/5.0Sn/2.5Ag	296	287
Indalloy®159	90.0Pb/10.0Sn	302	275
Indalloy®163	95.5Pb/2.5Ag/2.0Sn	304	299
Indalloy®171	95.0Pb/5.0Sn	312	308

Contact our expert today: shomer@indium.com

Learn more: www.indium.com/IGBT

From One Engineer To Another®

©2017 Indium Corporation

Form No. 99384 (A4) R0



LOTMATERIAL NEU DEFINIERT

Innovative Produktionsmittel für IGBT-Montage

- Die-Attach
 - InFORMS®
 - BiAgX®
 - Hochreine lotbänder
- Substrat-Montage
 - InFORMS®
 - Hochreine lotbänder
 - LV1000 Flux-Coating
- Kühlkörpermontage mit Heat-Spring® technologie
 - Heat-Spring® mit Indium-Anteil: bis zu 86W/mK
 - HSMF Heat-Spring®: Silikonfreies thermisches Polymer-Interfacematerial (TIMs)
 - Sn+ Heat-Spring® für höchste thermische Anforderungen



DIE-ATTACH-LOTMATERIAL

InFORMS®:

- Geringes Voiding
- Minimiert Verkippung von Substrat und Die
- Hohe Zuverlässigkeit

Indium8.9LDA:

- Entwickelt für IGBTs und Vakuum-Lötprozesse
- Sehr niedriges Voiding
- Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften



Bezeichnung	Legierung	Solidus (°C)	Liquids (°C)
Sn63	63.0Sn/37.0Pb	183 (eutektisch)	
SAC105	98.5Sn/1.0Ag/0.5Cu	217	225
SACm®	98.5Sn/0.5Ag/1.0Cu+Mn	217	225
Indalloy®241	95.5Sn/3.8Ag/0.7Cu	220	217
Indalloy®256	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu	220	217
Indalloy®121	96.5Sn/3.5Ag	221 (eutektisch)	
"J" alloy	65.0Sn/25.0Ag/10.0Sb	223 (eutektisch)	
SnCu	99.3Sn/0.7Cu	227 (eutektisch)	
Sn992	99.2Sn/0.5Cu+Bi+Co	227 (eutektisch)	
Indalloy®133	95.0Sn/5.0Sb	240	235
Indalloy®259	90.0Sn/10.0Sb	250	272
Indalloy®182	80.0Au/20.0Sn	280 (eutektisch)	
Indalloy®228	88.0Pb/10.0Sn/2.0Ag	290	267
Indalloy®151	92.5Pb/5.0Sn/2.5Ag	296	287
Indalloy®159	90.0Pb/10.0Sn	302	275
Indalloy®163	95.5Pb/2.5Ag/2.0Sn	304	299
Indalloy®171	95.0Pb/5.0Sn	312	308

Sprechen Sie noch heute mit unserem Experten: akarch@indium.com

Hier erfahren Sie mehr: www.indium.com/IGBT

From One Engineer To Another®

©2017 Indium Corporation

Formular No. 99384 (A4) R0

